

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

2020年11月3日投资者关系活动记录表

编号：2020-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	方正富邦、同泰基金、红塔红土、创金合信、幂方资本、深圳中金银海投资基金、深圳龙腾资产、鼎夏投资、民生证券、金友创智资产管理有限公司
时间	2020年11月3日上午
地点	公司本部商务会议室
上市公司接待人员姓名	李丽杰、张国、刘玉婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议主要介绍了公司的发展战略，核心竞争优势，产品与业务、公司情况，以及未来发展方向，并就调研投资者关心的合肥项目及配套募集资金情况、公司前三季度业绩情况等有关问题进行了解答。</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>公司成立于1985年，经过三十五年的发展，是全球领先的电子产品制造服务（EMS）专业提供商，在电子产品制造领域拥有逾三十年的技术沉淀和工程制造经验积累，有完善的精细化管理体系，有国际化的管理团队和海外网络，是业内国际化大客户的核心供应商和战略合作伙伴，规模优势及资源优势明显。产品主要应用于计算机、网络通讯消费电子、智能移动终端、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能领域，业务已形成聚焦发展半导体封测及模组、高端制造、自有品牌（以计量产品为主）三大产业领域的发展模式，公司未来将积极推动产业转型升级，着力培育高质量发展新引擎。</p> <p>关于集成电路半导体封测及模组领域：公司目前是国内唯一具有从</p>

集成电路高端DRAM/Flash 晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，具备多层堆叠封装技术，公司是国内唯一具有与世界知名中央处理器制造商开展测试验证合作资质的企业，所经测试过的存储器产品可直接配套其服务器投向市场，协助国内产业链上下游实现其平台的快速验证。

目前公司芯片封测产品主要包括DDR3、DDR4，LPDDR3、LPDDR4、eMCP、USB、eMMC、ePOP、SSD、3D NAND以及Fingerprint指纹芯片等，具备wBGA/FBGA等国际主流存储封装技术，在此基础上不断研发先进封装FlipChip/超薄晶圆隐形切割技术、嵌入式系统级芯片封装技术。

在存储产品领域，目前产品主要包括内存模组、USB 存储盘（U盘）、Flash 存储卡、SSD 等存储产品，公司采用行业领先的生产制造工艺，为客户提供包括SMT制造、测试、组装、包装及全球分销服务，提供存储集成电路设计、制造、封测的配套业务。

关于高端制造领域：作为电子产品先进制造企业，经过三十五年的发展，是业内国际化大客户的核心供应商和战略合作伙伴，并为全球多家一线品牌厂商提供技术制造服务，近年来，公司持续深化与该等业务客户合作的深度和广度。业务主要包括计算机存储、通讯与消费电子、医疗器械、汽车电子等。

在计算机与存储方面：公司有35年的业务历史，掌握硬盘磁头与硬盘盘基片核心制造技术，拥有自主知识产权的全自动高精密头堆、盘基片生产线，目前产品包括硬盘磁头、硬盘电路板和盘基片。目前传统硬盘在大型计算机、视频监控等大容量存储及数据安全至关重要的领域依然有突出优势，且这个趋势将维持较长时间，未来公司将不断调整产品结构，持续加强技术工艺的改进与研发，跟随国际客户的发展，持续引入存储服务器、固态硬盘等业务的生产，延伸业务产业链。

在通讯与消费电子方面：由于国际局势及全球新冠疫情等因素，该业务受到一定程度的影响，但公司通过内部挖潜，在不断提升产线自动化和智能化的同时，持续提升成本管控能力，降本增效已初见成果。公司

根据该业务整体战略布局，已在积极拓展新客户业务渠道。

在医疗器械业务方面，深科技拥有通过广东省医疗器械质量监督检验所检测的无菌净化生产车间，具备医疗产品联合设计和制造能力，目前产品包括呼吸机、腹膜透析加温仪、智能血糖仪、医用手术显微镜等。深科技先后荣获全球最大呼吸机品牌商的最佳供应商奖及优秀供应商奖。未来公司将通过不断扩大医疗器械研发团队，加大“家用医疗产品”“便携式医疗器械”及“慢病管理类医疗器械”的生产技术研发投入，持续满足客户对未来产品的质量和生产技术升级需求。

在汽车电子业务：包括动力电池、超级电容等，动力电池领域公司与全球知名的汽车动力电池系统企业建立合作关系，目前已有数款产品进入量产阶段。在超级电容领域，公司与国际顶级超级电容厂商形成长期稳定的合作关系，目前主要客户为 MAXWELL和TECATE，单体制造生产线也已形成批量生产能力。公司未来将积极布局超级电容相关技术工艺的提升和产业化，运用自身丰富的EMS经验及先进技术，为客户提供高水平的生产制造服务。

关于自有品牌领域：主要以计量产品为主，由控股子公司深科技成都运营，该公司主营智能水、电、气等能源计量管理系统的全套解决方案及配套产品和服务，拥有20多年研发、营销及先进制造的丰富经验，已累计向全球30个国家80家电力公司出货智能电表6000余万台，在欧洲、亚洲、非洲和中南美洲等地区占有较高的市场份额，是最早将“中国设计”和“中国制造”输入欧洲的智能电表企业，以“品质、技术、服务”赢得了欧洲、亚洲、非洲、美洲等多个国家电力公司的青睐与信任。未来深科技成都将进一步提高技术研发实力，为市场提供更专业、更经济的智能用电产品及系统解决方案。报告期内，在新冠疫情大背景下，深科技成都业务屡创佳绩，营收同比大幅增长。

1、问：请介绍集成电路半导体封装与测试的业务情况？

公司作为目前国内唯一具有从集成电路高端DRAM / Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业，近年来持续发展先进封装测试技术，深入推进存储项目，与国内龙头存储芯片企业开展战略合作。公司可提供从芯片封测、SMT制造、IC组装到芯片销售的一站式服务，从封装

晶圆到完成内存成品小于7天,在行业内位于领先水平。

深科技专注存储封测16年,在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术,封测技术水平与国际一流企业同步;在WBGA、FBGA、FCBGA存储封装形式的工艺水平始终保持紧跟世界先进水平,目前主力产品包括3D NAND,DDR4,LPDDR4等;封装能力覆盖存储类全产品线,拥有精湛的多层堆叠封装工艺技术;拥有强大的系统级SiP封测能力可支持5G技术,积极支持国内自主可控的芯片封测产业链。可基于现有系统级封装技术,将不同功能不同类型的晶片整合到一个芯片内,实现设计特种功能。广泛应用于多产品线与应用行业,比如5G芯片,射频相关通讯类芯片,以及消费电子主芯片等应用。面对国内外存储芯片向高速、低功耗、大容量发展的趋势,公司继续推动DDR5、GDDR5等新产品的技术开发。未来,深科技将继续保持在高端内存存储器封装测试行业的领先优势,致力于打造国内集成电路制造完整产业链。

2、问:定增募集资金投资存储先进封测与模组制造项目情况

公司于10月17日发布非公开发行预案,计划募集不超过17.10亿元建设存储先进封测与模组制造项目。整个项目由合肥沛顿存储科技有限公司实施,预计投资30.60亿元,建设内容包括:(1)DRAM存储芯片封装测试业务,计划全部达产后月均产能为4,800万颗;(2)存储模组业务,计划全部达产后月均产能为246万条模组;(3)NAND Flash存储芯片封装业务,计划全部达产后月均产能为320万颗。建设期3年,预计全面达产后可实现年产值28.63亿元,项目税后内部收益率为15.22%。

3、问:本次募投项目的预期回报情况如何?对此公司是否有战略意图规划?

据公司测算,该项目全面达产后,预计可实现年产值28.63亿元,项目税后内部收益率为15.22%,投资税后静态投资回收期为7.59年。

本项目实施后,可满足客户较大需求的DRAM、Flash存储芯片封测以及DRAM内存模组制造业务,有助于国内存储器芯片封测的深度国产化。随着本次募投项目的实施,有利于打破国内存储器领域对进口产品的依赖

和技术壁垒，加速存储器国产化替代进程，提升国产存储器芯片的产业规模，促进我国存储器产业链发展。

4、问：沛顿科技在项目公司的出资来源

公司拟向不超过35名特定对象发行不超过8933万股（不超过发行前股本总数的6.07%）募资总额不超过17.10亿元，作为沛顿科技向沛顿存储的出资资金，沛顿科技将以自有资金缴付首期出资款，待公司收到非公开发行股份募集资金后再予以置换。

5、问：请介绍项目的技术来源

本项目技术来源于公司全资子公司沛顿科技自主研发与长期积累，沛顿科技存储芯片封装制程采用的是当前高端产品的主流技术，如wBGA、LGA、SOP、TSOP、QFN、系统级SiP封装技术等，现有产品已实现多达16层的多晶堆叠技术，最大单颗芯片容量可达到256G。

沛顿科技具备DDR4封装和测试技术，采用的BGA、LGA等封装技术优势明显，产品合格率高，交货周期快，产品质量稳定，领先于国内其他竞争对手；沛顿科技的日本研发团队开发测试方案和程式，提供定制化服务的支持，技术工艺竞争优势明显。

沛顿科技专注存储芯片封测业务16年以上，拥有国内先进水平的封装和测试生产线，在封测行业已有多年的生产技术积累经验，是国内最大的DRAM和Flash存储芯片封装测试企业之一。公司产品技术、制造工艺与世界先进水平同步。

目前，沛顿科技主要从事动态随机存储（DRAM）、闪存（Flash）芯片、嵌入式存储产品、SSD和指纹逻辑芯片的封装和测试业务，目前主要为wBGA、DDR3、DDR4，eMCP、USB、SSD闪存芯片以及指纹逻辑芯片等提供封测服务，是国内唯一具有从高端DRAM/Flash/SSD存储芯片封测到模组、成品生产完整产业链的企业。

6、问：各投资方占股情况如何

沛顿存储注册资本30.60亿元，深科技全资子公司沛顿科技、大基金

二期、合肥经开投创和中电聚芯分别出资17.10亿元、9.50亿元、3亿元和1亿元，依次持股55.88%、31.05%、9.8%、3.27%，深科技拥有绝对控股权。

7、问：对外投资设立沛顿存储会对公司产生什么影响

本次投资旨在满足市场高性能存储芯片未来发展及新增产能持续扩张需求，打造公司集成电路半导体业务的长远竞争力，是公司寻求更高水平发展的重要战略选择。符合公司集成电路战略发展及产业布局规划，在满足现有客户产能持续扩张需求的同时有助于进一步拓展集成电路业务的经营渠道，不断推动产业转型升级实现公司可持续健康发展。本次投资将为公司未来长远发展奠定坚实的基础，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

8、问：2020年前三季度业绩情况

今年以来，面对复杂严峻的国内外形势，公司紧紧围绕战略布局，在现有电子产品先进制造服务核心业务基础上，积极推动产业转型升级，已形成聚焦发展半导体封测、高端制造、自主品牌（计量系统为主）三大产业领域的发展模式。2020年1-9月，公司稳步推进国内外市场开拓，持续深化与行业高端客户业务合作的深度和广度，产品综合毛利率提升，带动了公司经营业绩的增长。2020年前三季度营业收入为105.72亿元，同比增长4.81%，实现归母净利润4.46亿元，同比增长62.25%。报告期内由于人民币兑美元汇率波动产生外币评估损失以及本期衍生品到期交割收益较上年同期减少，导致财务费用同比大幅增加，对公司经营业绩亦产生一定的不利影响。但即使在此情况下，公司仍实现扣非归母净利润3.61亿元，同比增长170.96%。（详见公司已披露的2020年度第三季度报告全文）

9、问：深科技城市建设如何？

深科技城一期将建有三栋产业研发用楼和商业建筑，受新冠疫情影响及旧改制约等因素，项目工程进展有所调整。深科技城项目未来将建成以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，

	<p>在满足自用的前提下将以出租为主，届时将为公司带来更为充沛的现金流。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2020年11月3日